

HẠNG MỤC QUẢN LÝ	TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ	THỜI GIAN QUẢN LÝ	CHU KỲ	PHƯƠNG PHÁP
NHIỆT ĐỘ GIA NHIỆT	150°C~180°C	60~120S	2 lần/ ngày	Profile <i>Áp dụng với ADT,ESL, Power Module</i>
	150°C~180°C	90~120S		Profile Áp dụng cho model 7Seg UCSED048GERO UCSED085GER2 UCSED085GER3
NHIỆT ĐỘ TAN CHẢY	220°C-Peak-220°C	45~80S	2 lần/ ngày	Profile Solder <i>Áp dụng với ADT,ESL, Power Module</i>
NHIỆT ĐỘ PEAK	230°C ~ 250°C		2 lần/ ngày	Profile
	250°C ~ 260°C			<i>ESLGW215XX004</i> <i>ESLGW215XX007</i> <i>ESLGW215XX001</i>
COOLING TIME	220°C ~ 150°C	2 ~ 3°C/Sec	2 lần/ ngày	Profile
TỐC ĐỘ BĂNG TẢI	80~120cm/min	Toàn thời gian	2 lần/ ngày	Profile REFLOW > 10 ZONE
	65-100 cm/min			REFLOW 8 – 10 ZONE
KHOẢNG CÁCH PCB	10cm trở lên	Toàn thời gian	4 lần/ ngày	Checksheet

REFLOW BOND

HẠNG MỤC QUẢN LÝ	TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ	THỜI GIAN QUẢN LÝ	CHU KỲ	PHƯƠNG PHÁP
NHIỆT ĐỘ TAN CHẢY TOP (4 Dây đo)	130°C-Peak-130°C	100 ~ 120 S	2 lần/ ngày	Profile TOP
NHIỆT ĐỘ MẶT BOTTOM (2 Dây đo)	Max 120°C	Max 20s		
NHIỆT ĐỘ PEAK	130°C~150°C			